

SEMICON Japan 2014 出展のお知らせ

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長:町田 精孝)は、半導体製造に関連する専門展「SEMICON Japan 2014」に出展いたします。

同展示会は出展企業数 700 社以上、来場者数は約 65,000 人以上が見込まれており、「品質改善」や「コスト削減」をテーマに、理想的な製造ラインを実現する TMEIC 独自の知見・技術を応用したソリューションをご紹介します。

会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースにもご来臨賜りますようお願い申し上げます。

1. 展示会名	SEMICON Japan 2014 (Web Site) http://www.semiconjapan.org/ja/
2. 場所	東京ビックサイト 東展示棟・会議棟
3. 開催日時	2014 年 12 月 3 日(水)~5 日(金)の 3 日間 10:00-17:00
4. 入場費用	展示会は全来場者登録入場制です(無料)。 ※セミナー・レセプションの料金は別途登録・費用がかかる場合があります。
5. 弊社ブース	ホール 5 ブース番号 5427
6. 弊社展示製品	(1) <u>窒素無添加方式超高濃度オゾンガス発生装置</u> 半導体用ウェハの大口径化や、ますます多様化する LSI、メモリの製造プロセスも各用途に 対応できる超高濃度タイプ(OP-H シリーズ)、必要な機能をコンパクトにパッケージしたオールインワンタイプ(OG-P/H-R シリーズ)など、幅広くラインナップしています。 (2) <u>Mist-CVD</u> 非真空プロセス下で、環境負荷が少なく下地基板へのプラズマダメージがない太陽電池の 透明導電膜やパッシベーション膜を実現しました。設備のコンパクト化、発電効率の向上、太陽電池製造コスト低減などお客様のニーズにお応えします。またMist-CVDは、今後ますます応用範囲が広がる有機EL、高機能フィルム、ナノテク素材などにおいても従来のウェットコーティング技術では適用厳しいナノクラスの薄膜化実現にも貢献いたします。 (3) <u>超音波ボンダ</u> 鉛フリーで耐熱性の高いパワーモジュールを超音波ボンダの直接接合技術が実現します。熱ダメージの無い常温接合プロセスは薄膜太陽電池や有機 EL 照明などのガラス基板に成膜された電極膜に対しても直接接合を実現し、製造コストを大幅に削減します。 (4) <u>トータルエンジニアリング</u> 開発段階からお客様の製品試作と品質評価をサポートし、ユーザーとしての経験を活かして最適な量産ラインをエンジニアリングします。メーカーとしての技術力を結集し、Mist-CVD や超音波ボンダなどの製造装置と検査システムの最適な組み合わせをご提供します。

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 事業開発・広報部

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4645 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。